

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年8月20日(2009.8.20)

【公開番号】特開2008-34601(P2008-34601A)

【公開日】平成20年2月14日(2008.2.14)

【年通号数】公開・登録公報2008-006

【出願番号】特願2006-205930(P2006-205930)

【国際特許分類】

H 01 L 23/50 (2006.01)

H 01 L 23/48 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/50 U

H 01 L 23/48 P

【手続補正書】

【提出日】平成21年7月1日(2009.7.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体素子と、前記半導体素子の裏面が表面に固着されるアイランドと、前記半導体素子と電気的に接続されるリードと、前記半導体素子、前記アイランドおよび前記リードの前記アイランド側を一体に被覆する封止樹脂とを具備し、

前記アイランドの外周端部には、前記アイランドの表面から上方に向かって突出する突出部が設けられ、前記突出部は、前記アイランドの表面と角部を介して成る内側側面と、前記内側側面と対向して位置する外側側面と、前記内側側面と前記外側側面の間に位置する上面と、前記上面と対向して位置する下面とから成り、

前記内側側面および前記外側側面は、前記アイランドの表面に対して鋭角を成すように前記半導体素子側に傾斜している事を特徴とした半導体装置。

【請求項2】

前記下面是、前記半導体素子の実装領域側から外側に向かって下方に傾斜している事を特徴とした請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】

前記リードは、前記アイランドの一側辺側に、アイランドと一体の第1のリードと、前記半導体素子と電気的に接続された金属細線の接続部を有する第2のリードとを有する請求項1または請求項2に記載の半導体装置。

【請求項4】

前記アイランドの一側辺と対向する他側辺側には、前記アイランドと連結部を介して一体となるタブが設けられる請求項1に記載の半導体装置。

【請求項5】

前記第1のリードと前記アイランドとの連続する領域および前記連結部と前記アイランドとの連続する領域には、前記突出部が省略される請求項4に記載の半導体装置。

【請求項6】

前記アイランドには、前記半導体素子を固着する、実装時に半固形状または液状と成る接合材が設けられ、前記連結部の表面には、前記アイランドから前記タブ部に向かう方向と交差する方向に凹状部が設けられる請求項4または請求項5に記載の半導体装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置